

株式会社フェローテック

会社紹介資料



2025年9月

Ferrotec

会社紹介

商号	株式会社フェローテック	資本金	295億4,942万円
英文表記	Ferrotec Corporation	発行済株式数	47,117,949株(自己株式297,422株を含む)
設立	1980年9月27日	関連会社	[連結子会社]80社 [持分法適用子会社]13社
本社	東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル 5F	従業員	[連結] 15,983名 [単体] 583名
株式公開	東証スタンダード(証券コード:6890)		
代表者	代表取締役社長／グループCEO 賀 賢漢		

主な事業内容

1. 半導体等装置関連事業製品の製造販売

(真空シール、石英製品、セラミックス製品(ファインセラミックス、マシナブルセラミックス)、シリコンパーツ、CVD-SiC製品、石英坩堝、シリコンウェーハ、受託加工・組立等)

2. 電子デバイス事業製品の製造販売

(サーモモジュール、パワー半導体用基板、サーミスタ、磁性流体)

3. 車載関連事業製品の製造販売

(サーモモジュール、パワー半導体用基板、サーミスタ)

4. その他関連事業セグメント

(機械刃物、産業用クリーニング機器、インゴット引き上げ装置等)

顧客に満足を
地球にやさしさを
社会に夢と活力を

気づき、改善し、幸せを追求する企業。
それが私たちフェローテックです。

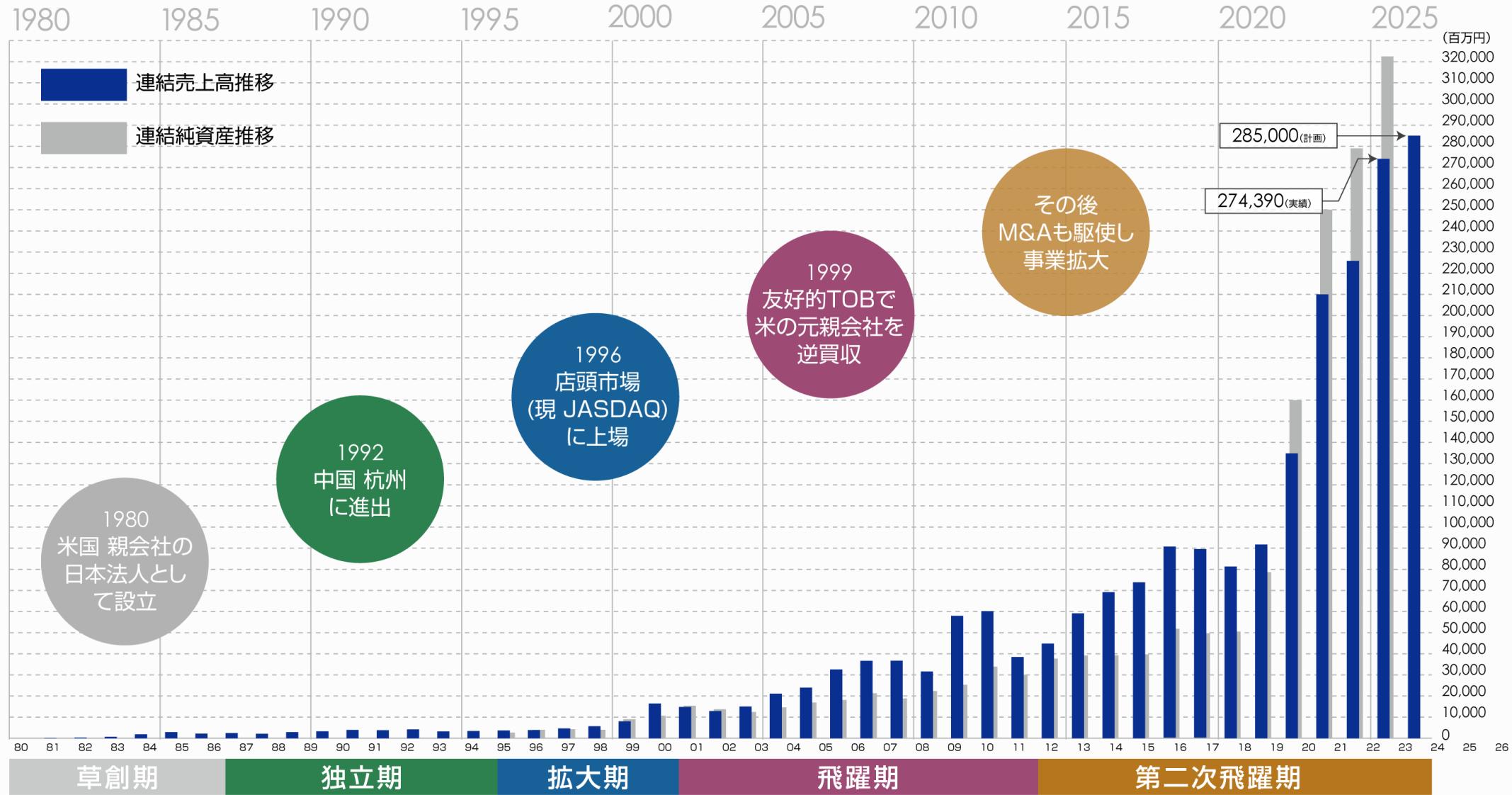
フェローテックはグローバルな視点のもと
国際社会や地域社会と調和を図り、
あらゆる人々の生活に貢献できる製品と
サービスを提供する企業として誠実に行動します。

お客様から信頼されて満足を頂くこと
地球環境問題の解決に貢献すること
ものづくりを通して社会に貢献することを掲げます。



会社の歩みと連結売上高の推移

FerroTec



事業概要

コア技術

- 当社事業の源流は「磁性流体」磁性流体応用製品の「真空シール」と温調デバイスの「サーモモジュール」で世界トップシェア

M&A

- 元来保有する事業以外を積極的なM&Aや戦略的提携で獲得し、相乗効果を最大限に発揮

4素材

- 半導体装置向部材：4素材（石英・セラミックス・シリコンパーツ・CVD-SiC）を保有
- 半導体製造装置メーカーの様々な課題をワンストップで対応可能

量産能力

- 製品を「米国で開発」→「日本で確立」→「中国で量産」で30年来運営
- 近年の市場動向や顧客ニーズに基づき、マレーシアと日本でも量産拠点を展開

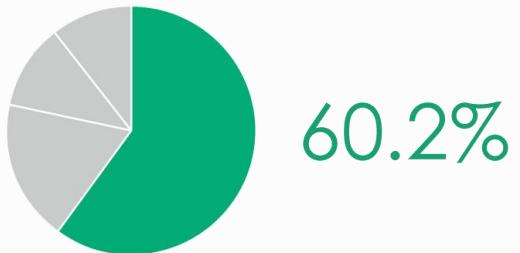
世界の顧客

- 日米欧だけでなく、中国国内においても優良企業と取引
- 世界的企業から各種表彰を受けるなど、サプライヤーとして高評価・信頼を獲得

成長性

- 会社の持続的な成長を追及し、株主にとって成長が楽しみな企業を意識

セグメント別 売上高構成比



半導体等装置関連セグメント



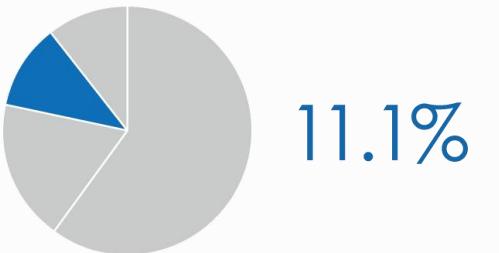
真空シール／石英製品
ファインセラミックス
シリコンパーツ
SiCパーツ (CVD-SiC)
スーパーマシナブルセラミックス
再生ウエーハ／石英るつぼ
装置部品洗浄／EBガン
精密蒸着装置／受託加工
半導体用シリコンウエーハ
SiCウエーハ



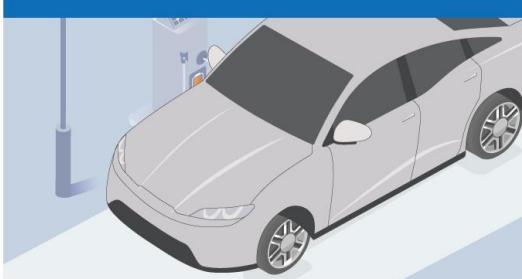
電子デバイスセグメント



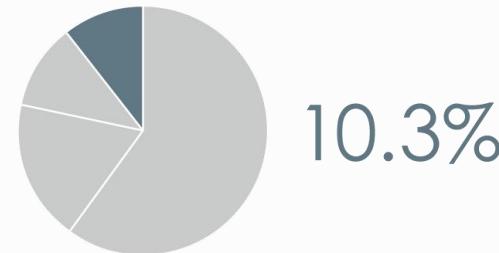
サーモモジュール
パワー半導体用基板
サーミスタ
磁性流体



車載関連事業セグメント



サーモモジュール・
アプリケーション
パワー半導体用基板
センサ

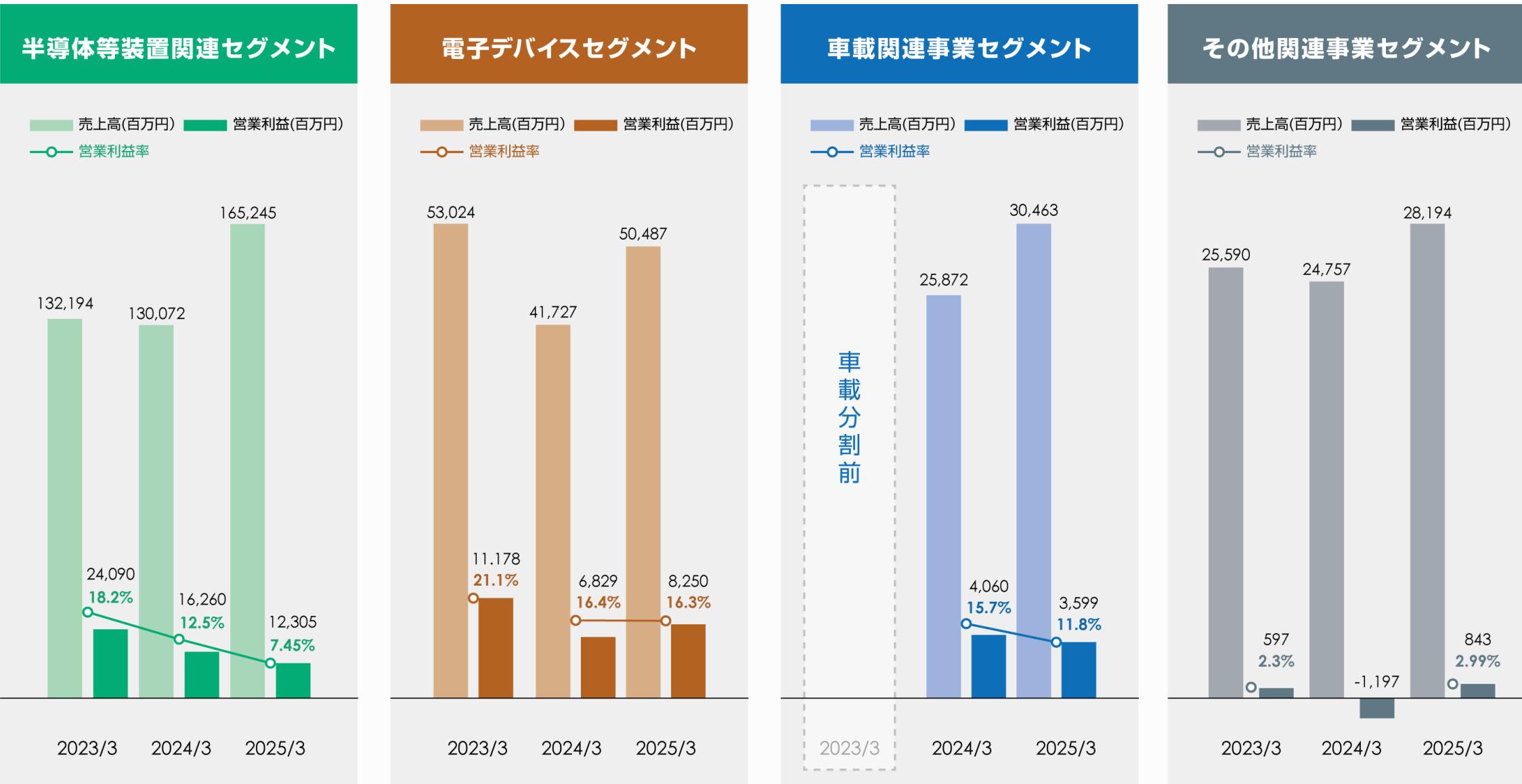


その他関連事業セグメント



工業用刃物
木工・金属加工用刃物
産業用クリーニング機器
インゴット引き上げ装置
各種製造装置

セグメント別 業績詳細



半導体等装置関連事業

半導体等装置関連事業では、半導体製造装置向け、FPD製造装置向けを中心に様々な製品・サービスを取り扱っております。磁性流体技術を応用した真空シール半導体製造装置で使用されるマテリアル製品(石英、セラミックス、シリコンパーツ、CVD-SiC等)や、金属受託加工サービス、部品洗浄サービスなどを手掛けております。また、製品量産化のために必要な技術とノウハウを豊富に蓄積しております。



真空シール

Vacuum Seals



石英製品

Quartz Products



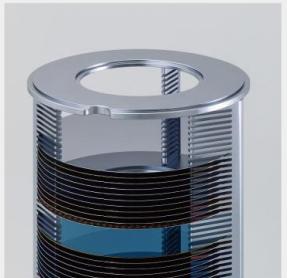
ファインセラミックス

Fine Ceramics Products



スーパーマシンアブルセラミックス

Machinable Ceramics Products



シリコンパーツ

Silicon Parts



SiCパーツ(CVD-SiC)

SiC Parts



石英るつぼ

Quartz Crucibles



受託加工・組立

CMS



装置部品洗浄

Process Tools Parts Cleaning



EBガン

EB Components



精密蒸着装置

Vacuum Coating System



再生ウエーハ

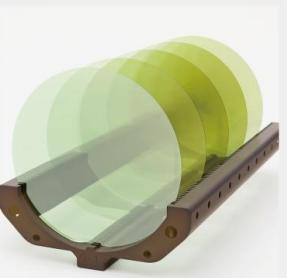
Reclaim Wafer



半導体用シリコンウエーハ

Silicon Wafers

※持分法適用関連会社



SiCウエーハ

SiC Wafer

※持分法適用関連会社

未来を創る半導体 その基盤を支えるフェローテック

半導体は数多くの工程を経て製造されます。

フェローテックの技術と製品は、その製造工程で
欠かせない存在となっています。

最新の技術トレンドに対応する製品群

技術革新に伴うこれからの半導体需要にフェローテックの半導体事業
は部材から加工まで数多くの製品で網羅します。



真空シール

高性能かつ高い歩留まりを誇る半導体は、製造工程において不純物のない密閉空間の確保が重要です。当社の装置開発製品は多くの工程でその性能を発揮します。

マテリアル製品

ウェーハ製造プロセスでは、当社のマテリアル製品は薄膜生成、搬送、洗浄工程で治具、消耗品として利用されています。



シリコンバーツ



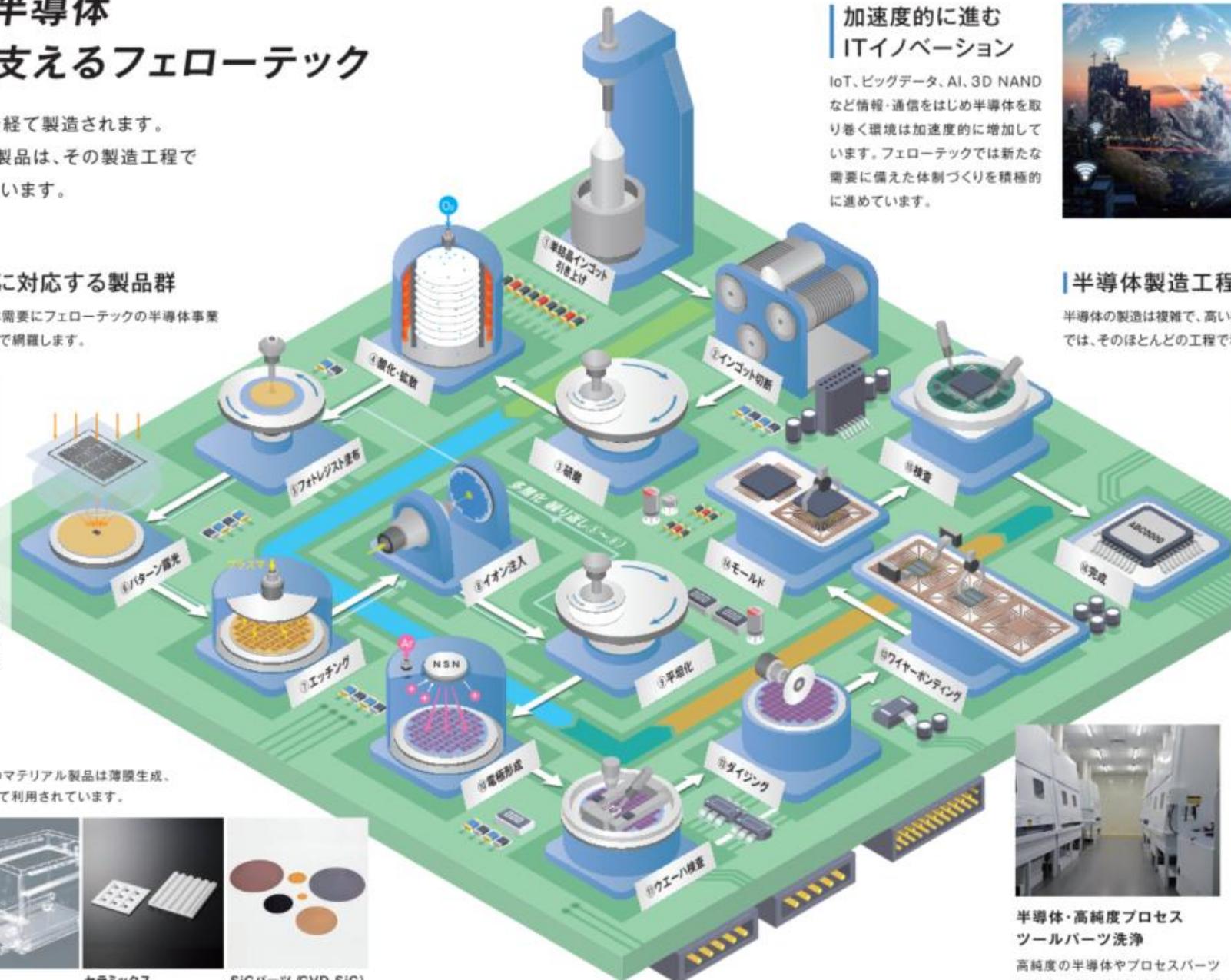
石英製品



セラミックス



SiCバーツ (CVD-SiC)



加速度的に進む ITイノベーション

IoT、ビッグデータ、AI、3D NANDなど情報・通信をはじめ半導体を取り巻く環境は加速度的に増加しています。フェローテックでは新たな需要に備えた体制づくりを積極的に進めています。



半導体製造工程で貢献

半導体の製造は複雑で、高い技術力を必要とします。フェローテックでは、そのほとんどの工程で利用可能な製品を提供しています。



シリコンウエーハ生産

中国工場でシリコンウエーハを単結晶から一貫製造しています。6インチ以下の小口径に続き、2017年度より8インチウエーハの生産を開始。



半導体・高純度プロセス ツールバーツ洗浄

高純度の半導体やプロセスバーツを洗浄。最新の微細化であるサブ28nmにも対応します。



受託加工

真空シールやシリコン結晶引き上げ装置で培った精密金属加工技術や装置生産技術によりお客様のニーズにお応えします。

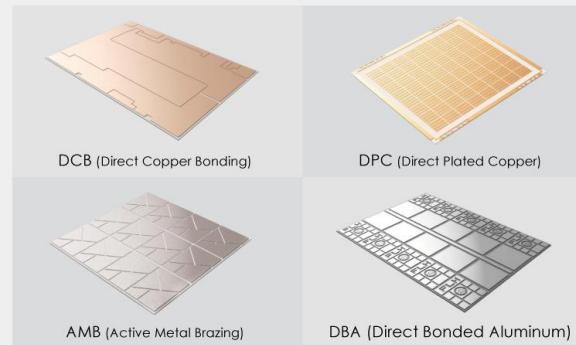
電子デバイス事業

電子デバイス事業では、サーモモジュール(ペルチェ素子)、パワー半導体用基板、磁性流体、温度センサ(サーミスタ)等を取り扱っております。これらの製品は用途範囲が広く、医療機器や半導体、通信分野、産業機器など幅広い産業で活躍しています。また、用途や仕様に合わせ様々なカスタマイズに対応しております。



サーモモジュール

Thermoelectric Modules



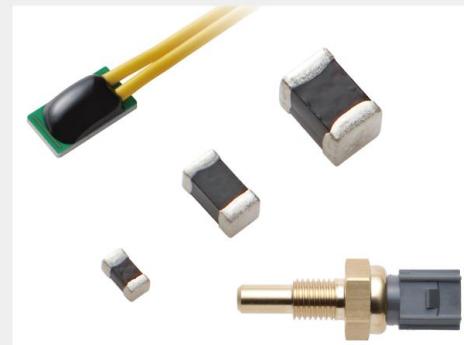
パワー半導体用DCB, AMB, DPC, DBA基板

Power Semiconductor DCB, AMB, DPC, DBA Substrates



磁性流体

Ferrofluid



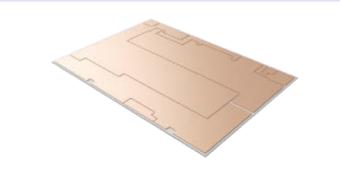
サーミスタ

Thermistor Sensors

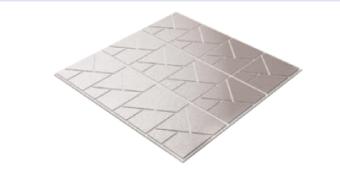
車載関連事業

半導体市場を中心に成長する当社は、今後EV(電気自動車)、PHV(プラグインハイブリット車)、自動運転システム等、アプリケーションの大きな変化が見込まれる自動車市場向けに、パワー半導体用基板、サーモモジュール(ペルチエ素子)、温度センサ(サーミスタ)などの導入を進めてまいります。

[主な製品] パワー半導体用基板



DCB基板



AMB基板

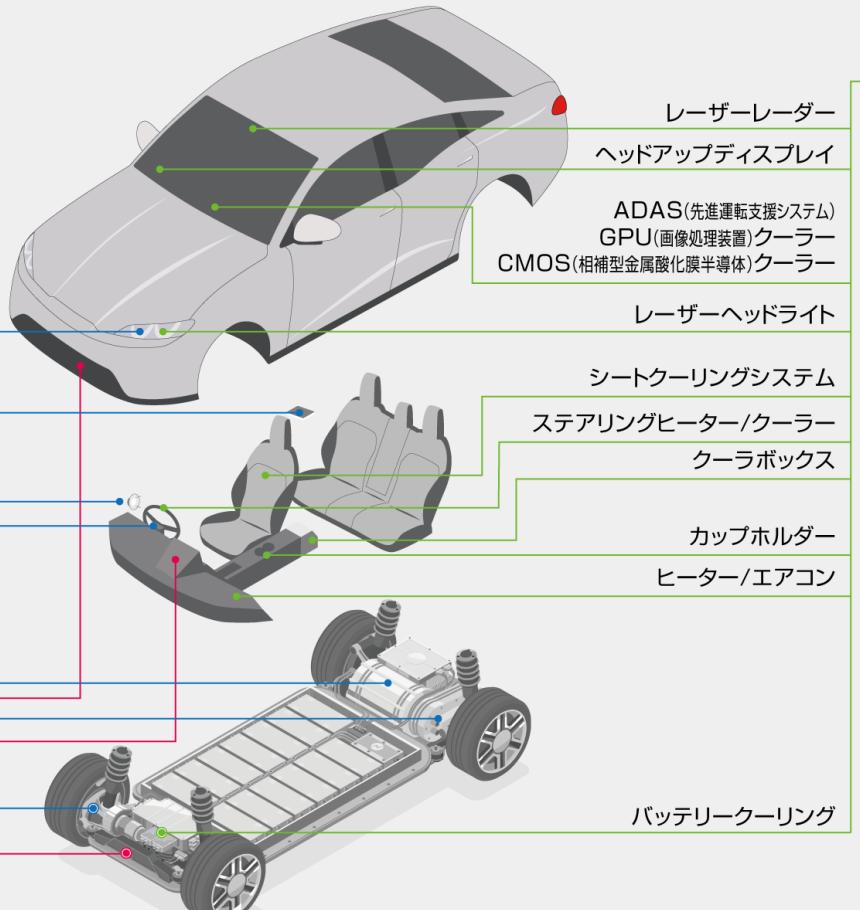
- ヘッドランプ制御
- ルームランプ制御
- AV・アクセサリ制御
- ステアリング制御
- モータ制御
- トランスミッション制御
- ブレーキ制御

[主な製品] サーミスタ



サーミスタ

- 吸気エアー量用
- 吸気エアー温用
- 車内温度用
- ディーゼル燃温用
- ラジエーター水温用



[主な製品] サーモモジュール



レーザーレーダー



自動車用温調シート



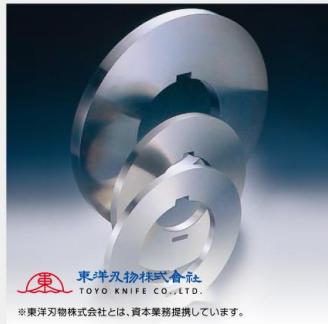
クーラボックス



カップホルダー

その他関連事業

フェローテックグループでは、主力事業以外にも、情報産業用、鉄鋼用、木工・金属用の刃物、リネン系分野の業務用洗濯機、シリコンやSiCのインゴット引上げ装置なども手掛けております。これらの製品は日本や中国をはじめ、その他の海外拠点や事業ネットワークを通じ、世界中のお客様にお届けしております。



工業用刃物

Industrial knife



木工・金属加工用刃物

Wood processing /
Metalworking sawblade



産業用クリーニング機器

Industrial Cleaning



12インチ半導体用
単結晶引き上げ装置

12-inch Semiconductor
Single Crystal Silicon Ingot Puller



6~8インチSiC引き上げ
インゴット引き上げ装置

6-8 inch SiC Puller



各種製造装置

Various production equipments

経営数値等

半導体・半導体製造装置市場の見通し

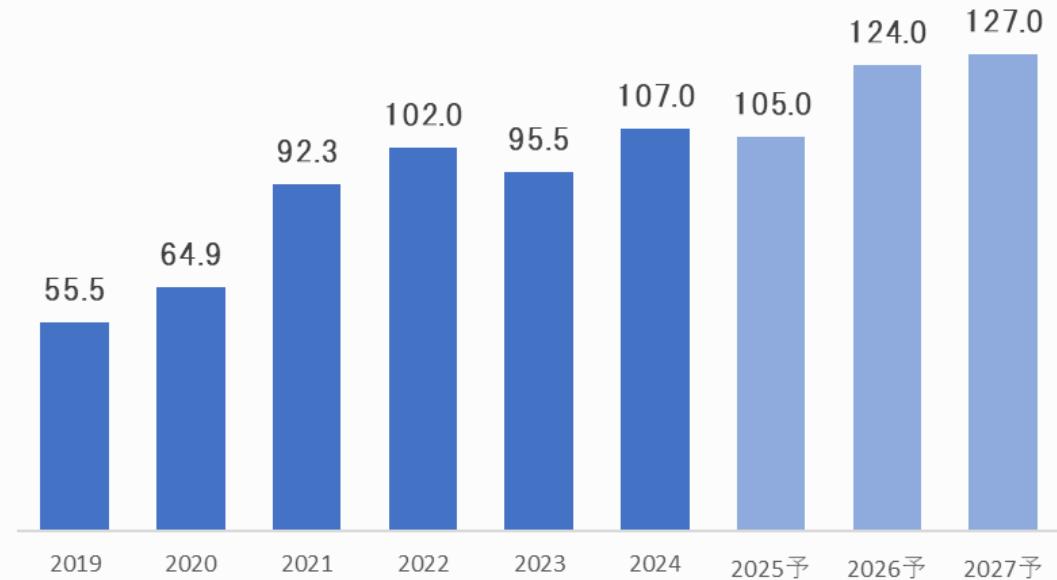
FerroTec

- » WFE（半導体製造装置）は中国向け輸出の減少等の影響で横ばい
- » 米国における政策先行き見通せず足許は不透明も、中長期的には市場は伸長予測

半導体市場予測



WFE（半導体製造装置前工程）市場予測



(10億米ドル)	2019CY	2020CY	2021CY	2022CY	2023CY	2024CY	2025CY
半導体需要	410.3	440.4	555.9	574.1	520.1	626.9	697.2
前年比成長率	-0.5%	+7.3%	+26.2%	+3.3%	-9.4%	+20.5%	+11.2%

※WSTS発表資料

(10億米ドル)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025予	2026予	2027予
WFE市場金額	55.5	64.9	92.3	102.0	95.5	107.0	105.0	124.0	127.0
前年比成長率	-6.0%	+16.9%	+42.2%	+10.5%	-6.4%	+12.0%	-1.9%	+18.1%	+2.4%

※某証券会社統計を一部加工

(百万円)	25/3期（実）	26/3期（予）	27/3期（計）	28/3期（計）	
売上高	274,390	285,000	340,000	400,000	
営業利益	24,089	28,000	35,000	47,000	
営業利益率	8.8%	9.8%	10.3%	11.8%	
当期純利益	15,692	16,000	20,000	29,000	
ROE	7.1%	→			15%
ROIC*	3.9%	→			8%
自己資本比率	39.4%	→			40%
設備投資	51,776	65,000	45,000	30,000	
1株当たり配当金（年間）	141.0円	148.0円	· DOE（連結株主資本配当率**) を採用し、下限を3.5%に設定 · 自社株式取得を機動的に検討、総還元性向50%を目指す		

*ROIC = 親会社帰属純利益 ÷ (有利子負債 + 純資産)、純資産は新株予約権、非支配株主持分除く

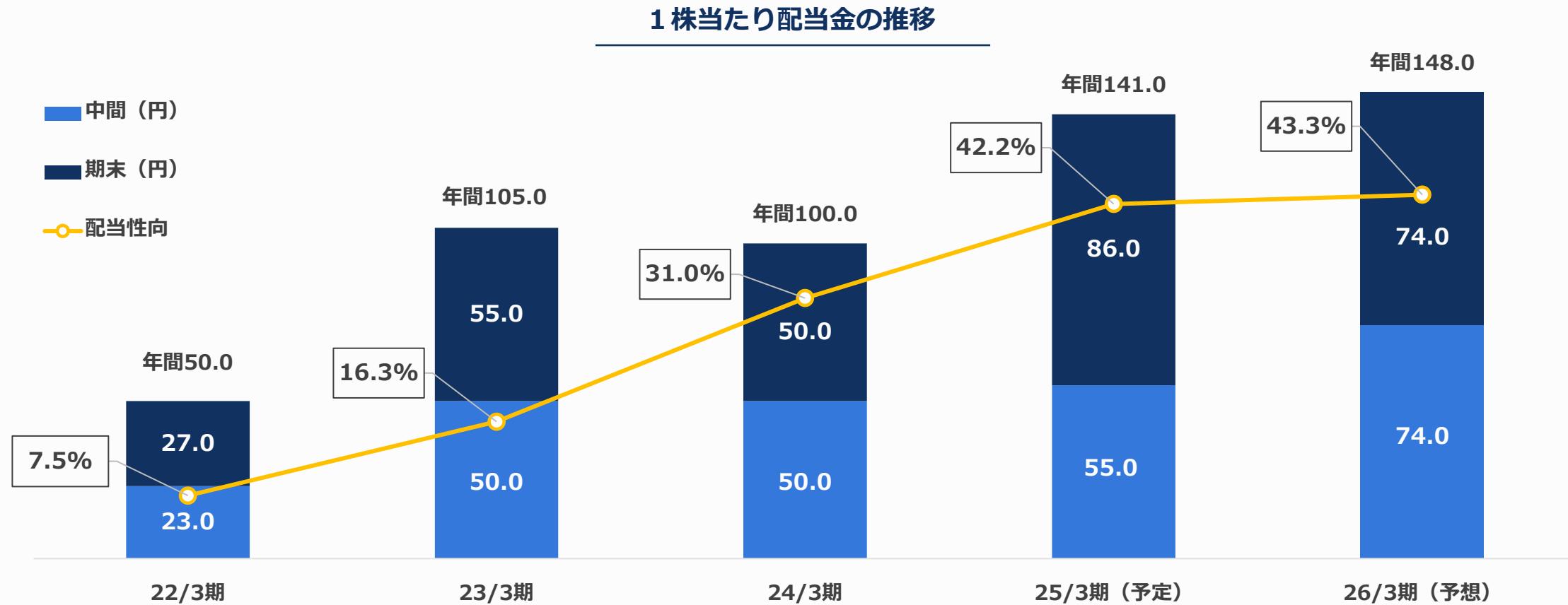
**連結株主資本 = 資本金 + 資本剰余金 + 利益剰余金 - 自己株式、連結株主資本配当率 = 配当金総額 ÷ 連結株主資本

26/3期 セグメント・製品別の業績予想（上期・下期）

FerroTec

(百万円)	25/3期 実績			26/3期 予想					
	通期	上期	下期	通期	前期比	上期	前年同期比	下期	前年同期比
半導体等装置関連	165,245	84,042	81,202	177,402	7.4%	84,210	0.2%	93,192	14.8%
真空シール・金属加工	39,195	19,347	19,848	49,774	27.0%	24,395	26.1%	25,379	27.9%
石英製品	31,930	16,134	15,795	31,930	0.0%	15,634	△ 3.1%	16,296	3.2%
シリコンパーツ	13,687	7,172	6,514	12,968	△ 5.3%	6,485	△ 9.6%	6,483	△ 0.5%
セラミックス	33,155	15,448	17,707	39,142	18.1%	17,647	14.2%	21,495	21.4%
CVD-SiC	8,192	3,992	4,199	8,162	△ 0.4%	3,728	△ 6.6%	4,434	5.6%
EBガン・LED蒸着装置	8,242	4,076	4,166	6,127	△ 25.7%	2,737	△ 32.9%	3,390	△ 18.6%
ウエーハ加工	10	10	△0	0	-	0	-	0	-
再生ウエーハ	2,856	1,251	1,605	4,427	55.0%	2,137	71.0%	2,290	42.5%
部品洗浄	15,306	7,061	8,245	17,597	15.0%	8,247	16.8%	9,350	13.4%
石英坩堝	12,668	9,547	3,121	7,275	△ 42.6%	3,199	△ 66.5%	4,076	30.6%
電子デバイス	50,487	23,085	27,401	56,921	12.7%	27,150	17.6%	29,771	8.6%
サーモモジュール	27,225	12,431	14,794	31,181	14.5%	14,858	19.5%	16,323	10.3%
パワー半導体基板	18,152	8,692	9,460	16,719	△ 7.9%	8,680	△ 0.1%	8,039	△ 15.0%
磁性流体・その他	1,137	575	562	1,370	20.4%	608	5.7%	762	35.3%
センサ	3,971	1,387	2,584	7,652	92.7%	3,005	116.7%	4,647	79.8%
車載関連	30,463	14,304	16,159	35,878	17.8%	16,338	14.2%	19,540	20.9%
サーモモジュール	6,412	3,108	3,304	5,113	△ 20.3%	2,539	△ 18.3%	2,574	△ 22.1%
パワー半導体基板	19,250	9,628	9,621	22,953	19.2%	10,546	9.5%	12,407	28.9%
センサ	4,801	1,567	3,233	7,813	62.7%	3,252	107.5%	4,561	41.0%
その他	28,194	13,723	14,470	14,799	△ 47.5%	7,303	△ 46.8%	7,497	△ 48.2%
合計	274,390	135,157	139,233	285,000	3.9%	135,000	△ 0.1%	150,000	7.7%

- » 株主還元の強化を図るため、新たにDOE（株主資本配当率）を採用し下限を3.5%設定
- » 持続的な収益増強により配当水準の引上げを目指すとともに、財務の状況等を考慮しながら、自社株式の取得を機動的に検討し、総還元性向は50%を目指して充実を図っていく



- » IRポータルサイト「IR STREET」にIRニュースを掲載・メール配信しております。
以下のQRコードもしくはリンクより、配信先メールアドレスをご登録いただけます。

日本語



[登録ページリンクはこちら](#)

English



[Go to Registration Page](#)

- ・本資料に掲載されている将来見通しの記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因の仮定を前提としております。
- ・実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる可能性があります。業績に影響を与える要素には、国際情勢、経済情勢、製品の需給動向、原材料価額及び市況、為替レートなどが含まれますが、これに 限定されるものではありません。
- ・本資料中の定量目標などは、あくまで中長期的な戦略、ビジョン等を示すものであり業績予想ではありません。当社はこれらについて情報を更新する義務を負いません。
- ・正式な業績予想は、東京証券取引所規則に基づく決算短信での開示をご参照ください。

ご清聴ありがとうございました